

证券代码：300400

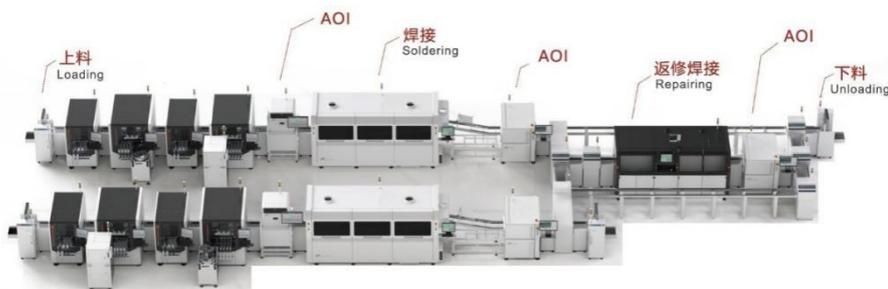
证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	海盾赢华基金（张健勇）、宝华盛基金（时岱）、国银资本（梅润昌）、中兴资本（叶凯华）、启富证券（何岩）、国诚投资（魏岗、徐斌、徐进波、戴剑磊）、创华投资（李军辉）等，合计约 15 名机构和个人投资者。
时间	2026 年 3 月 5 日（星期四）15:00 至 17:00
地点	劲拓光电产业园（深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 胡毅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>公司成立于 1997 年，2014 年在深交所创业板上市（股票代码 300400），是一家集研发、生产、销售和服务于一体的电子热工装备制造行业龙头企业，产品广泛应用于消费电子、通讯电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子、机器人电子元件等领域的精密制造。</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">图：公司电子制造专用设备的部分应用领域</p> <p>公司电子装联设备覆盖电子 PCBA 生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设备+AOI 和 SPI 检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统；作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊设备全球市场份额居前、系国家制造业单项冠军产品。上市 12 年以来，公司持续盈利，技术驱动是穿越周期的核心，公司近年持续加</p>

大研发投入，形成对底层技术的深刻理解，构建公司独特的竞争力。



图：零缺陷焊接检测制造系统示意图

（三）公司的经营情况

2025 年前三季度，公司实现营业总收入 59,561.31 万元，较上年同期增长 6.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,615.52 万元，较上年同期增长 42.80%；经营活动产生的现金流量净额 13,880.90 万元，较上年同期增长 81.84%；公司前三个季度呈现“收入稳健、盈利提速、质量向好”的良好态势。

公司 2025 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2025 年三季度报告》。

二、问答交流

1、如何看待劲拓股份在行业中的竞争优势？

回复：劲拓股份拥有全行业最完善的产品图谱，累计服务了全球 150+个地区的近 7000 家客户；同时公司凭借良好的供应链管控和售后服务体系，在行业树立良好的市场口碑和品牌形象；公司已多年牢牢占据电子热工装备行业的龙头地位。公司自 2023 年核心战略从“业务导向”转型为“技术导向”后，研发投入过亿，聚焦设备 AI 智能化，并与客户联合攻关服务于超大尺寸 AI 芯片焊接的热工设备。公司最早于行业提出热工设备三大智能化需求，在设备开发过程中积累大量物理数据，并初步实现公司与客户共同认可的设备智能化目标，目前已于行业率先开展客户现场设备实测，并与客户共同定义并探索下一代设备的智能演进方向，持续引领高端制造的智能化升级。与此同时，劲拓加大基础研究领域的研发投入，搭建出从方案仿真分析、模型设计到样机制备的闭环的电子热工装备前沿新技术产品开发体系，并深度参与客户项目开发，与客户共建工艺标准。公司有信心在 PCBA 行业的持续变化中保持竞争优势，特别是在当前数字化、智能化的浪潮中，成为行业发展的有力推动者。

2、公司未来业务发展的重点方向是什么？

回复：公司将继续聚焦热工装备的核心主业，加大研发投入，推进产品智能化、高端化升级；另外，公司也正在加大海外市场开拓，持续构建海外市场服务能力。

3、如何看待未来增长潜力，有哪些内外部因素可能影响增长？

投资者关系活动
主要内容介绍

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>回复：AI 产业的蓬勃发展和快升级技术迭代，正在对解决 AI 硬件制造过程的技术难题提出强烈需求。这些新变化正在驱动热工装备全新技术的开发和应用，并带来广阔的高端设备市场空间，劲拓力求以技术实力抓住时代机遇，持续为公司和产业发展创造价值。</p> <p>4、公司海外业务布局及马来西亚基地目前进展如何？</p> <p>回复：公司海外市场稳步拓展，马来西亚生产基地按计划推进能力建设。近期，公司加大了对马来工厂售后团队培训，招聘的马来售后工程师与新招聘的国内售后工程师，正在深圳总部开展系统性厂内训练，并准备投入到下一阶段与客户的售后联培，为后续客户复杂设备的全球化售后需求做好保障。</p> <p>5、公司研发团队如何规划？</p> <p>回复：公司正在建设跨多学科的基础研发团队，包括流体力学、金属材料、热力学等专业背景的人才，结合公司多年热工装备制造经验与数据，与客户联合技术攻关，应对大尺寸芯片焊接技术关键难题。此外，公司经过三年的 AI 工作，目前正在朝 AI 智能化开发的深度和广度方向培育智能化人才，推动设备从辅助智能向全面智能的升级。与此同时，公司加大产学研的合作，深入挖掘和利用设备开发过程中的物理数据，构建数字化模型能力，并最终实现其在热工装备领域的垂直化应用。</p> <p>6、公司大尺寸芯片焊接项目当前进度如何？</p> <p>回复：公司作为关键技术联合攻关方，已经积累了三年的开发和样机运行数据及工艺数据。公司在研的超大尺寸集成电路专用回流焊设备已完成多代版本的迭代，最新型号的设备配置可满足更加广谱的生产环境和产品工艺要求。公司开发的样机就客户提出的严格要求已开展多轮测试和设备验证工作。除此之外在测试环节，劲拓创新性的自研和应用了多项全新的检测设备和测试方案，实现更加准确的预测和反馈样机测试结果。公司已经与客户建立技术深度合作关系，大尺寸芯片焊接项目开发工作正在有序推进。</p> <p>三、现场参观</p> <p>调研人员有序参观了公司研发实验室和部分生产车间，了解公司在电子热工设备、AOI 设备和 SPI 检测设备及周边自动化设备的生产成果。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 3 月 5 日</p>